

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2012-006

## 天水华天科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	华天科技
股票代码	002185
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常文瑛	王亚斌
联系地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
电话	0938-8631816	0938-8631990
传真	0938-8630216	0938-8632260
电子信箱	htcwy2000@163.com	wyb@tsht.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,308,920,880.27	1,161,237,632.02	12.72%	777,436,881.45
营业利润 (元)	49,372,005.37	122,696,013.75	-59.76%	85,415,000.65
利润总额 (元)	86,613,334.38	130,945,149.94	-33.86%	89,571,065.64
归属于上市公司股东	78,956,088.94	111,871,226.26	-29.42%	77,139,928.19

的净利润（元）				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,742,280.40	104,922,334.69	-54.50%	73,634,078.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	218,474,741.88	292,492,802.70	-25.31%	232,522,604.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	2,307,030,104.16	1,741,504,924.80	32.47%	1,311,514,713.58
负债总额（元）	858,523,092.30	723,294,081.81	18.70%	392,018,035.22
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,443,210,674.32	1,013,736,585.38	42.37%	915,848,024.87
总股本（股）	406,130,000.00	373,230,000.00	8.81%	287,100,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.2085	0.2997	-30.43%	0.2067
稀释每股收益（元/股）	0.2085	0.2997	-30.43%	0.2067
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1261	0.2811	-55.14%	0.1973
加权平均净资产收益率（%）	7.10%	11.61%	-4.51%	8.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.29%	10.89%	-6.60%	8.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5379	0.7837	-31.36%	0.8099
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5536	2.7161	30.83%	3.1900
资产负债率（%）	37.21%	41.53%	-4.32%	29.89%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	69,946.41		-247,100.91	-27,548.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,922,942.64		9,542,643.75	4,249,125.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,439.96		-1,046,406.65	-65,512.01
所得税影响额	-5,974,421.78		-1,309,043.23	-623,409.75
少数股东权益影响额	-53,098.69		8,798.61	-26,805.97
合计	31,213,808.54	-	6,948,891.57	3,505,849.27

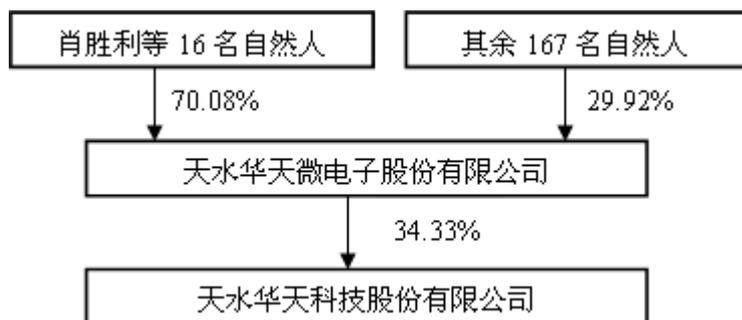
## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	36,329	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	38,920		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	34.33%	139,425,000	0	10,000,000
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	5.45%	22,118,400	3,000,000	0
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.38%	17,800,893	0	0
上海丹晨创业投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	8,400,000	8,400,000	0
宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.77%	7,200,000	7,200,000	0
上海涌信投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.67%	6,800,000	6,800,000	0
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	4,500,000	4,500,000	0
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,666,315	0	0
中融国际信托有限公司—融新 278 号	境内非国有法人	0.85%	3,457,454	0	0
杨国忠	境内自然人	0.74%	3,020,063	3,000,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
天水华天微电子股份有限公司	139,425,000		人民币普通股		
杭州友旺电子有限公司	19,118,400		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	17,800,893		人民币普通股		
盈富泰克创业投资有限公司	3,666,315		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—融新 278 号	3,457,454		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	3,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,720,179		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司	2,058,352		人民币普通股		
中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金	1,800,000		人民币普通股		
北京乐文科技发展有限公司	1,663,440		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

## 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### 一、报告期内经营情况回顾

2011 年公司加快实施了产业发展调整布局、工艺升级改造以及铜线制程扩产和材料优化升级工作：一是公司投资昆山西钛微电子科技有限公司 35%的股权，并参与该公司的生产管理工作，切入了 TSV 封装技术领域；二是华天科技（西安）有限公司正式投入运行，并于 2011 年 3 月底完成了相关产品的转移；三是华天电子科技园建成投产；四是加快铜线制程产品产能扩产和工艺升级以及材料优化。

2011 年，尽管公司集成电路封装量和营业收入较 2010 年分别增长了 19.27%和 12.72%，但由于原材料、人工成本、固定资产、财务费用增加以及调整搬迁等因素，使公司的营业利润和归属于母公司所有者的净利润较 2010 年分别下降了 59.76%和 29.42%。

#### 二、集成电路行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

##### 1、集成电路行业的发展趋势

根据中国国际金融公司关于电子元器件业“景气在纠结中见底”的观点，从 2012 年开始，超级本(Ultrabook)和智能电视将复制过去三年智能手机的繁荣，电子元器件一季度开始行业出货将逐季度环比增长，下半年将进入消费电子创新高潮，预计全年全球消费电子销售额达到 9,650 亿美元，其中，以智能手机、智能平板电脑、智能电视为核心的多种新技术带动了新一轮消费电子产品及其配件需求的高速增长。

国内方面，除智能终端的渗透拉动之外，信息技术在工业领域的深度融合渗透将加速推进，以集成电路为硬件核心的嵌入式系统更为广泛的应用，高性能 CPU、MCU、DSP、电源管理芯片等将继续推动集成电路产品的应用需求。根据 2011 年 12 月工业和信息化部发布的《集成电路产业“十二五”发展规划》，预计到 2015 年，国内集成电路市场规模将超过 1 万亿元，其中国内集成电路产业销售收入达到 3,300 亿元，年均增长达到 18%，满足国内近 30%的市场需求。

##### 2、公司面临的市场竞争格局

根据 CCID 关于集成电路封装市场统计数据和公司历年收入情况推算，公司在 2008-2010 年的市场占有率从 1.20%逐步提升至 1.85%，综合国内集成电路封装产业 2011 年的市场规模和公司 2011 销售完成情况，公司市场份额会进一步上升。虽然目前公司与国际半导体 IDM 公司在华设立的封装测试厂不构成直接竞争，但是随着封装订单和产能向内地持续转移，公司与国际专业代工厂将长期围绕质量、环境体系，工程、品质保证，工艺、技术支持，产业资源整合等诸多方面展开更加激烈的竞争。

#### 三、未来公司发展机遇和挑战

##### 1、公司面临的政策机遇

###### (1) 国发 4 号文和《集成电路产业“十二五”发展规划》助推产业发展能力迅速上升

2011 年 1 月 28 日，《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4 号正式发布，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面鼓励软件产业和集成电路产业发展。

2011 年 12 月，工业和信息化部发布了《集成电路产业“十二五”发展规划》(工信部规[2011]565 号)，其中将提升封测业层次和能力，发展先进封测技术和产品，作为提升集成电路产业核心竞争力的重要途径，写进了《规划》的四项发展重点。并将“芯片与整机价值链共建工程”、“先进工艺/特色工艺生产线建设和能力提升工程”、“集成电路产业链延伸工程”列入专栏计划。

预计随着 4 号文和《集成电路产业“十二五”发展规划》实施细则及地方政府配套政策的次第落实，政策带动效应将会自 2012 年起发挥积极作用。

###### (2) 公司发展将受益于区域发展规划

2012 年 2 月，国务院正式批复国家发改委组织编制的《西部大开发“十二五”规划》，将关中—天水地区列为优先发展的

重点经济区域之一，规划提出支持先进制造业、重要的科技创新基地加快发展；提高基础工艺、基础元器件产业化水平；新一代信息技术产业重点发展集成电路、元器件、电子材料等，发展新一代移动通信、平板显示、数字电视、下一代互联网核心设备和智能终端，促进物联网、云计算的研发和产业化；推进实施国家科技重大专项，开展新一代信息技术联合攻关；促进企业间、企业与高校、科研院所间的信息传递、知识流动和技术转让；强化企业创新和科技成果转化的财税金融政策；大力实施知识产权战略；培育一批具有国际竞争力的高新技术龙头企业等。新的西部开发规划，将和产业政策一起为公司创造良好的发展环境。

## 2、公司产能扩张和技术进步将为迎接新的市场机遇创造条件

### (1) 产能扩张带来的市场机遇

2011年9月底，《铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目》建设完成，新增 QFP、LQFP、TQFP、eLQFP、QFN、DFN、SOP、SSOP、TSSOP 等中高端铜线封装产品 5 亿块/年的生产能力。另外，《集成电路高端封装测试生产线技术改造项目》和《集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目》正在建设当中。预计上述两个项目投产后，可分别新增 BGA、LGA、QFN、DFN、TSSOP 等高端封装产品 5 亿块/年的生产能力，新增 CP 测试 36 万片/年测试能力；新增 ELQFP、QFP、LQFP、TQFP、SSOP、SOP、MSOP、ESOP、SOT 等 9 亿块/年的生产能力。

募集资金投资项目的陆续投产，将进一步优化公司产品结构，大幅提升工艺技术水平、产品质量，为做优做强主业奠定产能基础。

### (2) 技术进步带来的市场机遇

①开展多圈 VUQFN、FCQFN 和 AAQFN 封装工艺技术开发。完成了 2 圈产品 VQFN68L、VQFN256L，3 圈 VQFN256L，以及 UQFN68L 和 UQFN64L 的工艺改进；完成了 FCQFN12L 框架设计和封装样品生产，并通过了 MSL3 可靠性考核；完成了 AAQFN 的先导调研、技术论证和框架再布线工艺验证。产品主要用在手机、数码相机、PDA 以及其它便携式小型电子设备上。

②LFBGA/TFBGA、SiP 等多个高端封装产品通过验证，其中 LFBGA/TFBGA、SiP 产品已经具备大规模生产能力，翘曲、冲丝、可靠性等品质达到国际同行先进水平。产品主要用在高清电视、RF-SIM 卡、平板电脑、数字监控、CAM 卡、手机基带、手机射频功率放大器、高频电信设备等。

③完成了一种 BUMPING 样片的开发和 Flip chip 研发线的建立，WLCSP\Flip chip 12PIN 的产品已经开始验证。

④TSV 完成了关键技术革新，突破了 47um 焊盘限制；新的结构设计保证了大芯片可靠性；找到了良品率提升的解决方法；解决了 WLO 高折射率镜头材料因粘滞度大，难以在非球面复制制程中应用的难题，完成了涵盖了 30 万、130 万、200 万、500 万和 800 万像素的晶圆级光学镜头产品设计。

目前，公司已与国内外客户在高清视频芯片、手机射频功率放大器、PMU、2.5G 基带芯片、照相（摄像）模组、电容触摸屏芯片封装等领域建立了良好的合作关系，随着智能终端和信息技术升级等新兴应用带来巨大市场机遇，2012 年将是公司借机全面改善产品、客户结构的关键之年，最终实现全面进入新型消费电子产品供应链的目标。

## 3、公司实现经营目标和发展战略存在的挑战因素及应对措施

### (1) 内部挑战及应对措施

#### ①质量管理面临的挑战及应对措施

随着公司产能的不断扩张，新技术、新工艺的大量应用，对质量管理提出了更高、更系统的要求。为此，公司需要持续不断的修订和完善质量管理规划，对设计、工艺、生产、供方控制、检验控制、人员培训及质量责任追溯等进行动态监控和落实。另外，部分产品交期的问题也要逐步得到有效解决。

#### ②客户结构面临的挑战及应对措施

截至 2011 年底，公司已与国内多数知名设计公司、与部分台湾、香港、韩国、美国客户建立了巩固或有前景的业务关系，逐步进入国际知名集成电路供应商名录。为此，公司将一如既往的致力于改善和优化客户结构，持续关注封装产品流向领域，逐步提升封装产品在移动终端等新型消费电子领域的广泛应用。

#### ③技术和管理人才相对短缺及应对措施

集成电路封装新技术和新工艺更新速度快，对企业的技术开发能力、生产与经营管理提出了更高要求，优秀的技术与管理人才尤其是高端人才主要集中在国际知名公司或东部地区，人才相对短缺成为制约公司更好发展的重要因素。为此，我们热忱欢迎有志于在集成电路行业发展的各类人才来公司开展卓有成效的工作。

### (2) 外部挑战及应对措施

#### ①市场竞争加剧的风险

根据中国行业研究网的研究报告显示，2012 年我国集成电路产业将面临“全产业链竞争”加剧、移动互联网带来的机遇稍纵即逝等突出问题。为此，公司将继续推动管理体系持续优化和大客户战略，紧紧围绕铜线产品、QFN、BGA 产品、TSV 技术的扩展和广泛应用等，培育新的收入和利润增长点，加快提升整体竞争力，按照既定发展战略奋力赶超，逐步建立在全球竞争中的独特优势。

#### ②材料成本持续上升的带来的成本控制风险

根据上海黄金交易所信息，Au9999 价格自 2011 年 1 月从 300 元/克左右上涨至 2011 年 12 月 330 元/克左右，全年涨幅达到 10.00%，其中 9 月 6 日创出历史新高 395.30 元，7-12 月份价格几乎都在 330 元/克以上大幅波动。主要材料价格上涨给公司成本管控带来很大压力，并将长期影响公司的盈利能力。为此，公司一方面通过工艺升级节省金线消耗，大幅提升铜线产品占比；另一方面，下决心利用套期保值工具控制材料成本，并通过有效方式对上游材料资源进行整合，逐步建立具有竞争力的材料供应链。

## 4、公司 2012 年度的经营计划

2012 年度生产经营目标为全年实现营业收入 16 亿元，生产经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路产品	130,892.09	106,295.74	18.79%	12.72%	19.02%	-4.30%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
集成电路产品	130,892.09	106,295.74	18.79%	12.72%	19.02%	-4.30%

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## § 6 财务报告

## 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

## 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

## 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

## 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

天水华天科技股份有限公司  
法定代表人：肖胜利  
二〇一二年三月十三日